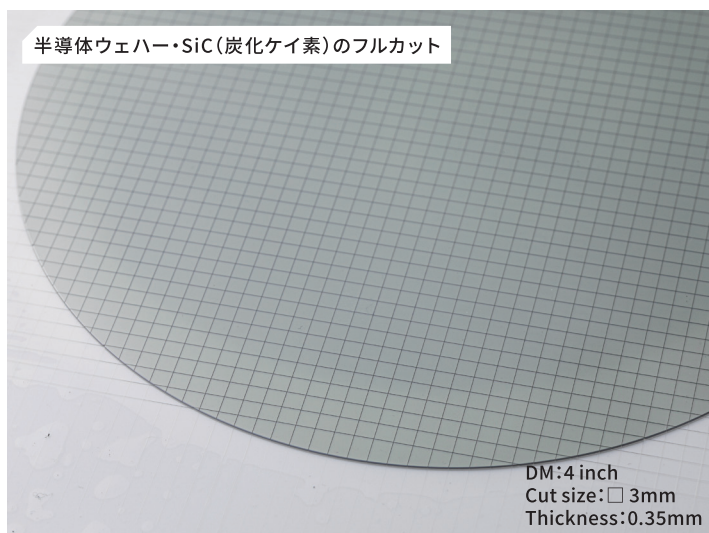




# Application

## Cutting カッティング

### 半導体ウェハー・SiC(炭化ケイ素)の音波フルカット



#### Point ここがポイント

- ブレードの耐磨耗性のアップ
- 大きなチッピングの防止
- 難切材の高速カット
- ダメージが発生しない

#### Product used 使用する装置

- SCS



AP-J-0070A4-2022082201